



2021年11月吉日

株式会社 SIRC

プレスリリース

SIRC と ETS ホールディングスが資本業務提携を行いました

5mm 角のスマートチップ「SIRC デバイス」を活用した IoT ソリューション及び AI エッジコンピューティングソリューションを提供する株式会社 SIRC(サーク)(大阪市、代表取締役 CEO 高橋真理子)(以下、SIRC)は、株式会社 ETS ホールディングス(東京都豊島区、代表取締役社長 加藤 慎章)(以下、ETS ホールディングス)を引受先とした第三者割当増資を実施したことを発表いたします。

SIRC は、電流・電力・角度・周波数変換をリアルタイムに非接触で計測できる多機能・高機能の超小型センサ「SIRC デバイス」の技術を有しています。SIRC デバイスは約 5mm 角と小型サイズであることから、これまでのセンサでは配置できなかった個所に後付け設置が可能であり、通信システムと組み合わせることで、様々な用途範囲の IoT センサソリューションを提供しています。

ETS ホールディングスは、電力の安定供給や電気設備を中心としたインフラ設備の工事分野で高い専門性と技術力を保有しています。今後、ETS ホールディングスの高品質で信頼性の高い電気設備・インフラ設備工事の提供に SIRC デバイスの活用を検討していく予定です。

これからも SIRC は、既存の設備の IoT 化による省エネルギーに貢献するとともに、再生可能エネルギーや EV の普及に伴う新たな電力量の計量や取引ニーズに応える新たな製品の開発を進め、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与して参ります。

【株式会社 SIRC について】

株式会社 SIRC は大阪市立大学発ベンチャーとして、文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興

機構(JST)による「大学発新産業創出拠点プロジェクト(START)」の支援を受け、2015年2月に設立いたしました。

当社のコア技術である磁性薄膜を活用したセンサモジュール(SIRC デバイス)は、1つのセンサで4つの機能を発揮出来るマルチデバイスです。センサチップ部分は5mm角と超小型であり、電流、電力、角度、周波数抽出という機能を発揮します。

当社は、特許技術を活用したセンサチップの開発に加え、アプリケーションに応じた周辺回路の設計を行うことで、高付加価値センサモジュールを開発販売いたします。また、用途に応じてセンサ周辺部分のニーズ(通信、ソフト)にも対応していくことで、IoT時代のキーデバイスの提供とシステムソリューションを提供しています。



<会社概要>

会社名 株式会社 SIRC (英文表記:SIRC Co.,Ltd.)

所在地 大阪府中央区久太郎町2-5-31 本町寺田ビルディング901

代表者 代表取締役 CEO 高橋 真理子

事業内容 SIRC デバイスを活用した製品開発および販売、省エネルギーソリューションの提供、乗算デバイスを活用した研究開発事業

設立 2015年2月

ウェブサイト <https://sirc.co.jp/>

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 SIRC 広報担当

TEL 06-6484-5381

e-mail info@sirc.co.jp